

JP Published Applications -- Patent Information

Published Serial No. S63-55527

Title chip type film capacitor

Patent type U

Application Number S61-148724

Filing Date 1986-9-30

H 01 G 4/32

IPC 1/035

H 01 R 4/02

SHIRAI YOICHI

Inventor IZUMI TAKEO

MIYAGI SEIICHIRO

Applicant	Name	Country	Individual/Company
	NEC Infrontia Corporation.	JP	Company

Abstract

A chip type film capacitor is made of a capacitor element. The capacitor element includes a flat electrode portion made by melting and injecting metal with high-melting point onto a sputtering portion of a terminal of a wiring mouth of a flat wiring body of a metal plastic film. The electrode portion protrudes from at least one flat surface of the wiring body. The chip type film capacitor is made by processing the capacitor element with the following steps including: immersing the capacitor element in plating solution after immersing in resin; and plating the electrode portion to form an electrode terminal of the element.

⑫ 公開実用新案公報(U)

昭63-55527

⑤ Int. Cl.⁴H 01 G 4/32
1/035
H 01 R 4/02

識別記号

庁内整理番号

A-6751-5E
7924-5E
7227-5E

④ 公開 昭和63年(1988)4月14日

審査請求 未請求 (全2頁)

⑥ 考案の名称 チップ型フィルムコンデンサ

⑦ 実 願 昭61-148724

⑧ 出 願 昭61(1986)9月30日

⑦ 考 案 者 白 井 洋 一 神奈川県川崎市高津区北見方260番地 日本通信工業株式会社内

⑦ 考 案 者 和 泉 武 郎 神奈川県川崎市高津区北見方260番地 日本通信工業株式会社内

⑦ 考 案 者 宮 木 誠 一 郎 神奈川県川崎市高津区北見方260番地 日本通信工業株式会社内

⑦ 出 願 人 日 通 工 株 式 会 社 神奈川県川崎市高津区北見方260番地

⑦ 代 理 人 弁 理 士 佐 藤 秋 比 古

⑥ 実用新案登録請求の範囲

金属化プラスチックフィルムの偏平状巻回体(該巻回体を巻回軸方向に矩形立方形状にきり出したものを含む)の巻口端部の金属蒸着部に接触して高融点金属を溶射してなる板状電極部を有し、該電極部が前記巻回体の少なくとも1偏平面より突出しているコンデンサ素子を、樹脂含浸処理後メッキ液中に浸し、前記電極部をメッキ加工し、素子の電極端子となしたことを特徴とするチップ型フィルムコンデンサ。

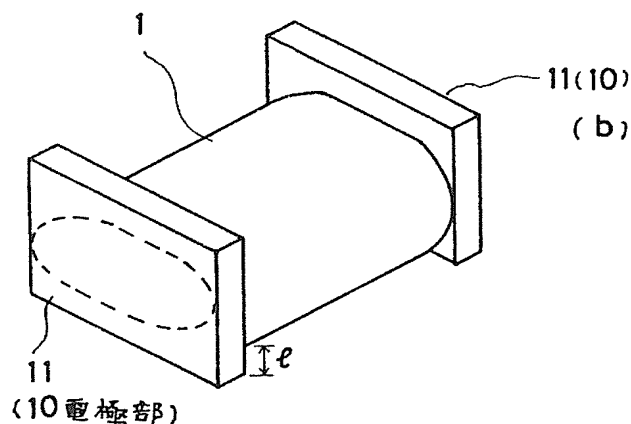
図面の簡単な説明

第1図は本考案の実施例の斜視図、第2図は電極部形成のためのメタリコンに用いる治具の斜視図、治具使用断面図、第3図は従来例の素子形状、製作工程を示す図、第4図は実施例および従来例をプリント基板に配置した状態を示す図である。

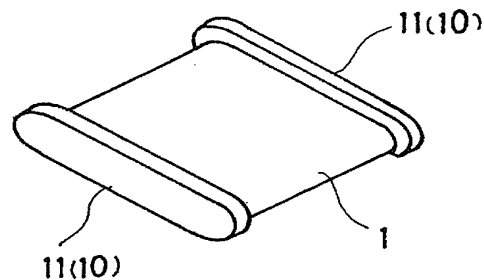
1……巻回体、10……電極部、11……電極端子、12a, 12b, 13a, 13b……治具の枠。

第1図

(a)

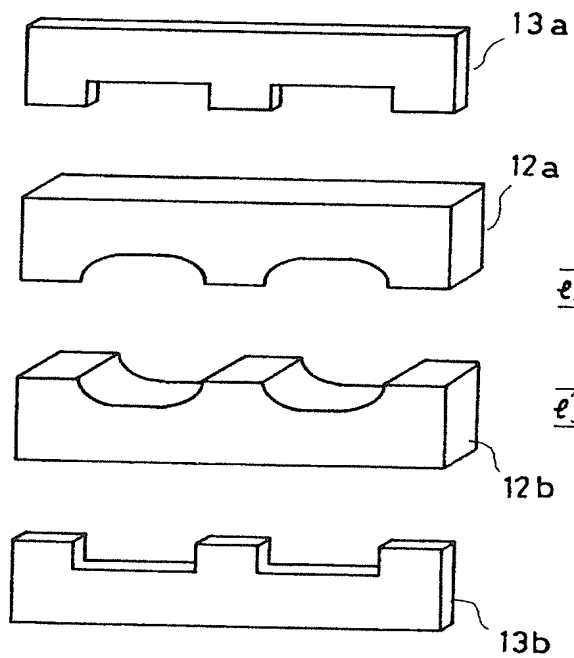


(b)

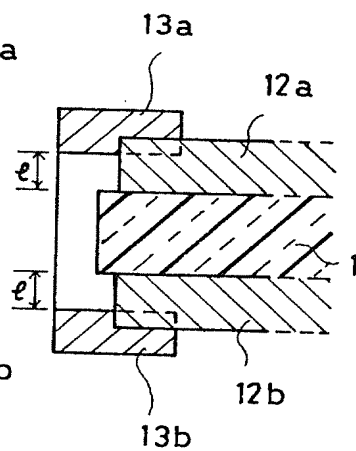


第 2 図

(a)

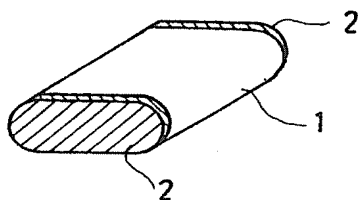


(b)

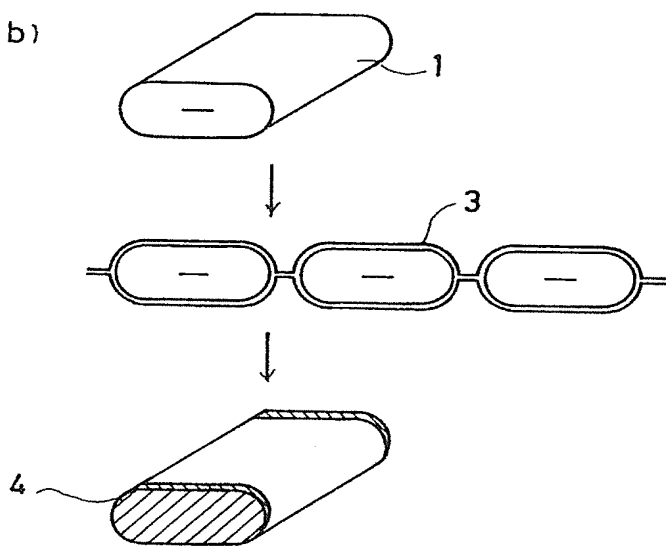


第 3 図

(a)



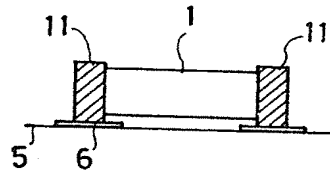
(b)



↓ 樹脂含浸, 電極部 4
メッキ処理

第 4 図

(a)



(b)

